

## PCBレポート2025

- ・発刊日：2025年7月22日
- ・体裁：A4/約280頁
- ・価格(税込)：440,000円(コーポレート契約)  
594,000円(グローバル契約)

株式会社 ジャパンマーケティングサーベイ

〒103-0004東京都中央区東日本橋2-24-12 東日本橋榭町ビル8F

| TEL: 03-5829-3891 | FAX: 03-5829-3892 | E-mail: info@jms21.co.jp | <https://www.jms21.co.jp>

# 調査概要

本調査は、グローバルPCB(プリント回路基板)市場における最新動向を明らかにし、今後の市場戦略立案や製品開発に資する情報を提供することを目的としている。

## 【主な調査ポイント】

### ■ 2024年のPCB市場分析

基板の種類別に市場規模と成長動向を分析

応用分野別に市場構成と成長性を把握

基板の種類別および応用分野別における売上上位5社(Top 5)を特定し、競争環境を明確化

### ■ 2022年～2034年の市場規模分析と予測

基板の種類別・用途別に、2022年～2024年の実績と、2025年～2034年の市場規模を予測(金額/数量)

市場における製品ミックスおよび応用分野ミックスの変化を分析、成長分野を抽出

基板の需要地域別および生産地域別の構成変化・動向を分析

### ■ グローバル主要メーカー動向(上位48社)

2021年～2024年における売上推移と市場シェアの変化を時系列で分析

メーカー別の設備投資動向、生産拠点・能力の最新情報を整理

各メーカーの主力基板タイプと主要応用分野における販売構成を比較・分析

# 調査内容/目次 -1-

## 第1章 総括

## 第2章 PCBの市場動向

### 2-1. PCBの市場動向(2024年)

2024年グローバルPCB市場規模

2024年PCBの種類別応用分野別販売状況

#### 2-1-1. 主要メーカーの基板種類別販売実績(2024年)

主要メーカーの基板種類別の販売実績(金額/数量)

片面基板の応用分野別の販売実績(金額/数量)

両面基板の応用分野別の販売実績(金額/数量)

多層基板(4-10L)の応用分野別の販売実績(金額/数量)

多層基板(12-20L)の応用分野別の販売実績(金額/数量)

多層基板(22+L)の応用分野別の販売実績(金額/数量)

HDI基板の応用分野別の販売実績(金額/数量)

ICサブストレートの応用分野別の販売実績(金額/数量)

FPC&R/F基板の応用分野別の販売実績(金額/数量)

その他の応用分野別の販売実績(金額/数量)

#### 2-1-2. 主要メーカーの基板種類別販売実績 ((金額/数量)

主要メーカーの応用分野別の販売実績(金額/数量)

コンピュータ向け基板の種類別販売実績(金額/数量)

モバイル向け基板の種類別販売実績(金額/数量)

通信インフラ向け基板の種類別販売実績(金額/数量)

コンシューマ向け基板の種類別販売実績(金額/数量)

自動車向け基板の種類別販売実績(金額/数量)

産業・医療向け基板の種類別販売実績(金額/数量)

軍需・航空向け基板の種類別販売実績(金額/数量)

ICサブストレート向け基板の販売実績(金額/数量)

### 2-2. PCBの種類別市場規模予測

PCBの種類別市場規模予測(金額/数量)

コンピュータ向け基板の市場規模予測(金額/数量)

モバイル向けの基板市場規模予測(金額/数量)

通信インフラ分野向けの基板市場規模予測(金額/数量)

コンシューマ向けの基板市場規模予測(金額/数量)

自動車分野向けの基板市場規模予測(金額/数量)

産業・医療向けの基板市場規模予測(金額/数量)

軍需・宇宙航空向けの基板市場規模予測(金額/数量)

ICサブストレート向けの市場規模予測(金額/数量)

### 2-3. PCBの応用分野別市場規模予測

応用分野別PCBの市場規模予測(金額/数量)

片面基板の市場規模予測(金額/数量)

両面基板の市場規模予測(金額/数量)

多層基板(4L-10L)の市場規模予測(金額/数量)

多層基板(12L-20L)の市場規模予測(金額/数量)

多層基板(22+L)の市場規模予測(金額/数量)

HDI基板の市場規模予測(金額/数量)

IC サブストレートの市場規模予測(金額/数量)

FPC&R/F の市場規模予測(金額/数量)

その他の基板の市場規模予測(金額/数量)

# 調査内容/目次 -2-

## 第3章 事例研究

### 日本メーカー

NIPPON MEKTRON, LTD.

IBIDEN CO., LTD.

MEIKO ELECTRONICS CO., LTD.

SHINKO ELECTRONIC INDUSTRIES CO., LTD.

Nitto Denko Corporation

Murata Manufacturing Co., Ltd.

CMK CORPORATION

Fujikura LTD.

Sumitomo Electric Industries, Ltd.

### 台湾メーカー

Zhen Ding Tech. Group

Unimicron Technology Corporation

Tripod Technology Corporation

WUS Printed Circuit Co., Ltd.

Compeq Manufacturing Co. Ltd.

Gold Circuit Electronics Ltd.

HANNSTAR BOARD CORPORATION

Nan Ya Printed Circuit Board Corporation

FLexium Interconnect. Inc.

KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP

Taiwan PCB Techvest Co., Ltd.

Dynamic Holding Co., Ltd.

Unitech Printed Circuit Board Corporation

Chin Poon Industrial Co., Ltd.

### 中国メーカー

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd.

Shennan Circuits Co., Ltd.

Shenzhen Kinwong Electronic co., Ltd.

Kingboard Holdings Limited

Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.

AKM Meadville Electronics (Xiamen) Co., Ltd.

Suntak Technology Co., Ltd.

Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co., Ltd.

Olympic Circuit Technology Co., Ltd.

Shengyi Electronics Co., Ltd

Aoshikang Technology Co., Ltd.

Delton Technology (Guangzhou) Inc.

Founder Technology Group Co., Ltd.

### 韓国メーカー

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.

BH CO., LTD.

Young Poong Group

LG Innotek Ltd.

Simmtech Co., Ltd.

Daeduck Electronic Co., Ltd.

ISU Petasys Co., Ltd.

SI FLEX CO., LTD

### 欧米メーカー

TTM technologies, Inc.

AT & S Austria Technologie

# <内容見本>

## PCBの種類別市場規模予測(金額ベース)

CAGR:2024-2034

		2022	2023	2024	2025	2026	2028	2030	2032	2034	CAGR
Single-sided											
Double-sided											
MLB	4-10L										
	12-20L										
	22+L										
	Sub total										
HDI											
IC Substrates											
FPC & R/F											
Others											
Total											

Value: Million USD

\*Others : including Metal substrate, Fluorine substrate, etc.

# <内容見本>

## PCBの応用分野別市場規模予測(数量ベース)

CAGR:2024-2034

	2022	2023	2024	2025	2026	2028	2030	2032	2034	CAGR
Computer										
Mobile										
Comm. Infra.										
Consumer										
Automotive										
Industrial/Medical										
Defense/Aerospace										
IC Substrates										
Total										

Volume: Thousand SQM

# <内容見本>

## 主要メーカーの基板種類別の販売金額2024年（1）

	single-sided	Double-sided	MLB			HDI	IC substrates	FPC & R/F	Others	Total
			4-10L	12-20L	22+L					
ZDT										
Unimicron										
DSBJ										
Mektron										
TTM										
Tripod										
Shennan										
Compeq										
WUS Group										
AT&S										
Kinwong										
Kingboard										
SEMCO										
Hannstar										
Victory Giant										
Ibiden										
Gold Circuit										
AKMM										
Meiko										
BH										
Youngpoon Group										
NanYa										
LG Innotek										
Simmtech										
Nitto Denko										

# <内容見本>

## 主要メーカーの応用分野別の販売実績2024年(1)

	Computer	Mobile	Comm. Infra.	Consumer	Automotive	Industrial Medical	Defense Aerospace	IC Substrates	Total	Volume
ZDT										
Unimicron										
DSBJ										
Mektron										
TTM										
Tripod										
Shennan										
Compeq										
WUS Group										
AT&S										
Kinwong										
Kingboard										
SEMCO										
Hannstar										
Victory Giant										
Ibiden										
Gold Circuit										
AKMM										
Meiko										
BH										
Youngpoon Group										
NanYa										
LG Innotek										
Simmtech										
Nitto Denko										

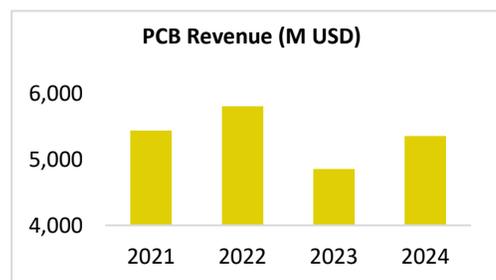
Unit: MUSD

## 企業概要

# Zhen Ding Tech. Group

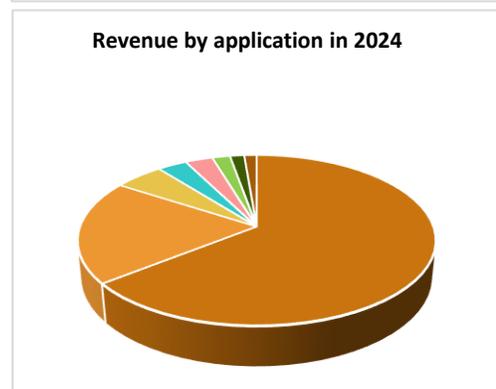
本社所在地	No.6, Lane28, Sanhe Road, Sanshi Village, Dayuan, Taoyuan, Taiwan			
従業員数	48,141名（連結、2024年12月31日現在）			
PCB事業売上高 (Million USD)	2021	2022	2023	2024

\*為替レート 2021: 1USD @ 28.49NTD, 2022: 1USD @29.49NTD, 2023: 1USD @ 31.21NTD, 2024: 1USD @ 32.05NTD



➤同グループは、 . . . . .

➤主力製品は . . . . .



➤近年は、 . . . . .

➤東南アジアで . . . . .

## 生産拠点

拠点名		生産品目	生産能力(k SQM/M)
China	Shenzhen	Shenzhen Park 1	
		Shenzhen Park 2	
		FCBGA Substrate Park	
	Huai'an	Huai'an Park 1	
		Huai'an Park 2	
		Huai'an Park 3	
	Qinhuangdao	Qinhuangdao Park	
		BT Substrate Park	
	Taiwan	Taoyuan Boardtek Park	
Kaohsiung AI Park			
India	Chennai Park		
Thailand	Prachinburi Park		

Thailand Prachinburi Park:

- Trial production . . . . .
- Phase I will focus on . . . . .
- Phase 2 will . . . . .

Kaohsiung AI Park:

- IC Substrates: . . . . .
- High-Layer Count . . . . .
- Flexible PCB Production Line: . . . . .

# <内容見本>

## 販売実績(金額/数量/2024)

		Value								Volume
		Computer	Mobile	Comm. Infra.	Consumer	Automotive	Industrial Medical	Defense Aerospace	IC Substrates	
Single-sided										
Double-sided										
MLB	4-10L									
	12-20L									
	22+L									
	Sub total									
HDI										
IC Substrates										
FPC & R/F										
Others										
Total										

Value: Million USD Volume: 000 SQM

# レポートの申込み要項

## 1. 契約形態/価格（税込み）

- 1) コーポレートライセンス契約：440,000円
- 2) グローバルライセンス契約：594,000円

※ ご利用はコーポレート契約では同一法人内に限定され、グローバル契約は出資比率51%以上の子会社までとなります

※コーポレート/グローバルのどちらのライセンス契約も（レポート+電子ファイル）で納品されます。また、グローバルライセンス契約は後日英語版も納品されます。

## 2. お申し込み方法

添付の調査申込書に所定事項をご記入の上、弊社宛まで電子メール(info@jms21.co.jp)もしくはFAX(03-5829-3892)にご送付下さい。

## 3. お支払い条件

請求書発行日の翌月末日までに銀行振込にて、お支払い下さい。

## 4. 調査レポートのお取り扱い

上記のご契約形態に従ってその利用範囲を限定させていただきます。

その契約形態を越えての第三者への譲渡を禁止とし、またそれ以外にも弊社(JMS)の著作権や版權を侵害しない事をお約束いただきます。

レポート内のデータを第三者に公表される場合は、事前に弊社にご相談ください。

# 申込書

年 月 日

## PCBレポート2025

申し込み形態（チェック☑お願いいたします）： コーポレート契約 グローバル契約

※前頁の「調査レポートのお取り扱い」に合意の上申込みます。

申込企業名：\_\_\_\_\_

申込責任者：\_\_\_\_\_ 同役職：\_\_\_\_\_

連絡担当者：\_\_\_\_\_

同所属：\_\_\_\_\_

所在地：（〒 \_\_\_\_\_ ）

TEL：\_\_\_\_\_ E-mail：\_\_\_\_\_

金額：\_\_\_\_\_（税込）

連絡事項：

--